

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2021-043

安集微电子科技（上海）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或者“安集科技”）对截止2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1、实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票13,277,095股，每股面值1.00元，每股发行价格39.19元。本次公开发行募集资金总额为520,329,353.05元，扣除总发行费用45,437,451.25元，实际募集资金净额为474,891,901.80元。实际到账金额计人民币483,927,759.01元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年7月17日出具了毕马威华振验字第1900382号验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

截至2021年9月30日，公司的募集资金余额为人民币302,547,779.39元。具体情况如下表：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到募集资金	483,927,759.01
减：募投项目累计使用金额	140,022,893.08
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	11,275,870.74
使用募集账户支付的募投项目款	128,747,022.34
减：永久补充流动资金	48,428,548.77
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	3,335,522.68
减：支付的其他发行费用	5,700,334.53
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	16,107,319.44
截至 2021 年 9 月 30 日募集资金余额	302,547,779.39

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理使用制度》。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三(四)方监管协议(以下简称“监管协议”)。

公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	募集资金专户账号	开户主体	初始存放金额	截至 2021 年 9 月 30 日余额
招商银行上海天山支行	121908362710905	安集微电子科技(上海)股份有限公司	120,000,000.00	121,200,964.58
平安银行上海自贸试验区分行	15842191613100	安集微电子科技(上海)股份有限公司	94,100,000.00	100,970.54
	15663715975369	宁波安集微电子科技有限公司	-	11,574,156.79
建设银行上海金桥支行	31050161373609588888	安集微电子科技(上海)股份有限公司	20,000,000.00	16,188,039.29
	31050161373609577777	安集微电子科技(上海)股份有限公司	69,000,000.00	320,167.40
	31050161373609566666	安集微电子(上海)有限公司	-	30,678,987.83
中信银行上海五牛城支行	8110201013401034448	安集微电子科技(上海)股份有限公司	180,827,759.01	122,484,492.96
合计			483,927,759.01	302,547,779.39

二、前次募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金的具体使用情况详见本报告“前次募集资金使用情况对照表”（见附表一）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

2021 年 4 月 28 日公司召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意“安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目”实施地点由原来的上海金桥出口加工区开发股份有限公司位于金桥出口加工区（南区）T6-8、T6-9、T6-10、T6-11 幢底层厂房变更为上海金桥出口加工区开发股份有限公司位于金桥出口加工区（南区）T6 号地块。

2021 年 8 月 25 日公司召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》，同意募投项目“安集微电子集成电路材料研发中心建设项目”新增安集微电子科技（上海）股份有限公司为该项目的实施主体；同意将募投项目“安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目”、“安集微电子集成电路材料研发中心建设项目”及“安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目”的建设期延长至 2023 年 7 月。除此之外募集投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容不存在变化。

3、募投项目先期投入及置换情况

2019 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 11,275,870.74 元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,335,522.68 元。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报

告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 1901009 号）。截至 2019 年 12 月 31 日，前述募集资金置换已实施完成。

4、对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

2019 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2020 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2021 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为零。

5、用部分超募资金用于研发中心扩大升级项目

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金扩大升级研发中心的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 13,000 万元用于研发中心扩大升级项目。

6、用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 48,428,548.77 元（含利息）永久补充公司流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓及日常经营活动等与主营业务相关的生产经营，不直接或间接投资与主营业务无关的公司。

7、尚未使用完毕募集资金的情况

截止 2021 年 9 月 30 日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 302,547,779.39 元（含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额），占前次募集资金净额的比例为 63.71%。前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，剩余募集资金将继续用于前次募集资金投资项目支出。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截止 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况参见“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”（见附表二）。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

六、前次募集资金使用情况的信息披露对照情况

公司已将上述募集资金的实际使用情况与公司其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

七、董事会意见

公司董事会认为，前次募集资金均已足额到位，公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，公司对前次募集资金的投向和进展情况如实按照证监会

《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）履行了披露义务。

前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币 元

募集资金净额：			474,891,901.80			已累计使用募集资金总额：			188,451,441.85	
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			-			2019 年度：			23,154,525.23	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2020 年度：			65,612,319.68	
						2021 年 1 月-9 月期间：			99,684,596.94	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日 期（或截 止日项目 完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额	
1	安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目	安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目	120,000,000.00	120,000,000.00	4,363,659.80	120,000,000.00	120,000,000.00	4,363,659.80	-115,636,340.20	2023 年 [注 2]
2	安集集成电路材料基地项目	安集集成电路材料基地项目	94,100,000.00	94,100,000.00	83,522,531.78	94,100,000.00	94,100,000.00	83,522,531.78	-10,577,468.22	2021 年
3	安集微电子集成电路材料研发中心建设项目	安集微电子集成电路材料研发中心建设项目	69,000,000.00	69,000,000.00	38,777,026.50	69,000,000.00	69,000,000.00	38,777,026.50	-30,222,973.50	2023 年 [注 2]

4	安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目	安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目	20,000,000.00	20,000,000.00	4,109,027.00	20,000,000.00	20,000,000.00	4,109,027.00	-15,890,973.00	2023 年 [注 2]
5	超募资金	安集微电子科技（上海）股份有限公司研发中心扩大升级项目	不适用	130,000,000.00	9,250,648.00	不适用	130,000,000.00	9,250,648.00	-120,749,352.00	2024 年
6		永久补充流动资金		48,428,548.77	48,428,548.77		48,428,548.77	48,428,548.77	-	不适用
合计			303,100,000.00	481,528,548.77 [注 1]	188,451,441.85	303,100,000.00	481,528,548.77[注 1]	188,451,441.85	-293,077,106.92	—

注 1：募集后承诺投资金额大于实际募集资金净额的原因系超募资金用于永久补充流动资金的金额含超募资金利息收入及理财产品收益。

注 2：公司于 2021 年 8 月 25 日经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目”、“安集微电子集成电路材料研发中心建设项目”及“安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目”的建设期延长至 2023 年 7 月。

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截至 2021 年 9 月 30 日投 资项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
序 号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月		
1	安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目[注]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	安集集成电路材料基地项目[注]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	安集微电子集成电路材料研发中心建 设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	安集微电子科技（上海）股份有限公司 信息系统升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	安集微电子科技（上海）股份有限公司 研发中心扩大升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：公司未对募投项目的效益做出承诺。截至 2021 年 9 月 30 日，安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目尚未达到预定可使用状态；安集集成电路材料基地项目 1 条生产线已达到预定可使用状态并投入使用，剩余 2 条生产线尚在安装调试阶段。公司将按照计划有序推进募投项目的资金投入。